北京燕东微电子股份有限公司
首次公开发行股票科创板上市公告书

(北京市朝阳区东直门外西八间房)

保荐人(主承销商) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO., LTD.

(北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

二零二二年十二月十五日

特别提示

北京燕东微电子股份有限公司(以下简称“发行人”、“燕东微”、“本公司”或“公司”)股票将于 2022 年 12 月 16 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

本上市公告书中所引用数据,如合计数与各分项数直接相加之和存在差异,或小数点后尾数与原始数据存在差异,可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节重要声明与提示

一、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上交所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn/)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中的相同。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽

上交所主板、深圳证券交易所主板,在企业上市首日涨幅限制比例为 44%,首日跌幅限制比例为 36%,之后涨跌幅限制比例为 10%。科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后 5 个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市 5 个交易日后,涨跌幅限制比例为 20%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。

(二)流通股数量较少

本公司发行后公司总股本为 119,910.4111 万股,上市初期,因部分原始股股东的股份锁定期为 36 个月,保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月,除保荐机构相关子公司之外的其他战略配售投资者本次获配股票的限售期为 12 个月,部分网下限售股锁定期为 6 个月。公司本次上市的无限售流通股为 119,644,800 股,占发行后总股本的比例为 9.98%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为制造业(C)中的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),截至 2022 年 12 月 2 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为 27.18 倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2021 年扣非前 EPS(元/股,人民币)	2021 年扣非后 EPS(元/股,人民币)	T-3日股票收盘价(元/股,人民币)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)
688396.SH	华润微	1.7180	1.5897	53.12	30.92	33.41
600460.SH	士兰微	1.0718	0.6322	35.97	33.56	56.89
600360.SH	华微电子	0.1205	0.1171	6.94	57.60	59.26
300373.SZ	扬杰科技	1.4990	1.3825	56.72	37.84	41.03
1347.HK	华虹半导体	1.4117	1.3718	23.71	16.80	17.29
均值					35.34	41.58

数据来源:Wind 资讯,数据截至 2022 年 12 月 2 日(T-3 日)。

注 1:以上 EPS 计算口径为:2021 年扣非前 EPS=2021 年扣非前归属于母公司净利润/T-3 日总股本,2021 年扣非后 EPS=2021 年扣非后归属于母公司净利润/T-3 日总股本;

注 2:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成;

注 3:华虹半导体人民币收盘价为港元收盘价 *汇率计算,2022 年 12 月 2 日人民币汇率中间价为 1 港元兑人民币 0.90687 元,该公司 2021 年扣非前后 EPS 也采用前述汇率折算为人民币单位。

本次发行价格 21.98 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 68.39 倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率 27.18 倍,高于同行业可比公司 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的平均静态市盈率 41.58 倍,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的

根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的。股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节风险因素”一节的全部内容,并应特别关注下列重要事项及风险因素:

(一)半导体工艺技术升级迭代风险

分立器件及模拟集成电路业务方面,发行人典型产品包括数字三极管、ECM 前置放大器、浪涌保护器件、射频功率器件等,采用的制造工艺以双极工艺为主。与 MOS 工艺相比,传统的双极工艺在功耗、饱和度、速度、输入阻抗、集成度等方面具有劣势,且应用领域相对较窄,市场容量较为有限,技术迭代较慢。此外,随着新的应用场景不断涌现,产品迭代速度较快,发行人需要根据市场需求不断优化产品设计,升级产品制造工艺,提升产品性能和质量管控水平,同时还要压缩单芯片面积,降低生产成本,提升产品的性价比。因此,如果出现成本更低或者性能更优的同功能的 MOS 工艺产品,而发行人未能对产品成本有效控制、未能持续优化产品设计提升产品性能,或新产品研发不及时,可能会削弱发行人产品的市场竞争力,市场占有率也会随之下降,甚至导致产品在终端应用中被替代,将会对发行人的收入规模产生消极影响。

特种集成电路及器件方面,近年来,随着技术的持续发展,特种集成电路及器件技术呈现高传输速率、小型化、专用化、模块化、系统化的发展趋势。该业务是发行人业绩的重要来源,若发行人无法及时跟进技术发展趋势,对特种集成电路设计及相关工艺进行推陈出新,特种集成电路及器件业务的规模将受到影响,进而影响发行人的持续盈利能力。此外,相比于竞争对手,发行人特种集成电路及器件生产线自动化程度有待进一步提高,可能对生产周期、生产成本造成不利影响,不利于保证产品交期和提高产品工艺、性能的一致性,可能导致公司在行业竞争中因交付速度和价格因素受到不利影响。

晶圆制造业务方面,发行人主要面向消费电子领域,代工客户需求更新迭代非常迅速,且产品品种较多。与对标公司相比,目前发行人产能较小,不利于发挥规模经济效应,可能在行业竞争中因产能问题产生成本劣势和供货劣势,不利于开发新客户及维护现有客户。此外,发行人 MOS 工艺平台的覆盖范围较华润微、士兰微、华虹半导体小,屏蔽栅 MOS 和超级结 MOS 工艺平台仍在小批量试生产过程中,而上述对标公司均已实现量产,导致公司在行业竞争中处于后发劣势。如果发行人工艺平台与客户产品匹配出现偏差、新品流片周期较长或者工艺平台的更新不能满足客户的技术需求变化,则可能导致发行人无法保证产品开发交付的时效性,进而对订单收入产生消极影响。

封装测试服务方面,发行人的封装服务主要包括 QFN、SOT 及 DFN 等形式,面向消费类产品,该类产品将持续向更薄、更轻、更小的方向发展;华润微、士兰微为配合 MOS 和 IGBT 的封装需求,功率器件封装以大功率的 TO 系列和模块系统封装为主。发行人未对 3D 封装和系统级封装等先进封装技术进行布局,如果发行人未能及时跟进客户的需求变动并对封装测试生产工艺进行更新,则可能在与封装测试领域其他企业的竞争中处于劣势,对发行人的封装测试业务业绩产生不利影响。

从发行人报告期内各业务收入构成来看,报告期内,发行人的主营业务收入主要来自特种集成电路及器件、晶圆制造服务和分立器件及模拟集成电路三类业务。2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月,上述三类业务主营业务收入占比合计分别为 70.95%、87.78%、95.10%和 98.31%。发行人没有持续扩大发展封测服务业务的规划,未来发展重心在于上述三类业务。如果上述三类业务发生前述风险,则可能较大程度影响公司的持续盈利能力。

(二)行业周期性及发行人经营业绩波动风险

报告期各期,公司主营业务收入分别为 100,688.18 万元、97,868.95 万元、198,518.16 万元和 112,846.84 万元,2020 年小幅下降,2021 年迅速增长,呈现出一定的波动;净利润分别为 -17,605.11 万元、2,481.57 万元、56,915.53 万元及 31,855.51 万元,2019 年亏损,自 2020 年起扭亏为盈,净利润持续增长,同样存在一定波动。

发行人的收入增长主要受下游市场需求、产品技术升级迭代等因素影响,其中,2020 年主营业务收入与 2019 年基本持平,主要是由于一方面特种集成电路及器件、晶圆制造两项业务收入增长明显,另一方面原子公司新相微 2019 年 12 月起不再纳入合并范围,2020 年相关收入减少,上述因素相抵后导致 2020 年主营业务收入基本保持不变;2021 年因下游市场需求增长,发行人特种集成电路及器件、晶圆制造两项业务单价增长显著,收入实现快速增长。毛利率方面,公司报告期各期主营业务毛利率分别为 21.68%、28.66%和 40.98%,毛利率逐渐提高。公司的毛利主要来自于特种集成电路及器件业务和晶圆制造业务等,毛利率的变动与产品收入结构、市场竞争程度等因素有关,且公司产品种类繁多,不同产品的性能、用途及成本、价格存在一定差异。随着公司收入的增长及毛利率的提升,公司净利润由负转正并显著增长。

公司身处半导体行业,半导体行业具有较强的周期性特征并与宏观经济和政治环境密切相关,是影响企业经营稳定性的重要因素。贸易摩擦的不确定性、政治环境波动等因素会造成市场整体波动,可能对包括公司在内的行业内企业的经营业绩造成不利影响。公司分立器件及模拟集成电路业务、晶圆制造业务、封装测试业务的终端应用以消费电子领域为主。报告期内,产品与方案板块方面,终端应用为消费电子领域的收入占比为 40.51%、34.51%、25.88%和 18.68%;制造与服务业务方面,终端应用为消费电子领域的收入占比为 84.94%、86.15%、75.13%和 75.54%,占比较高。近期,因下游市场需求减少、厂商前期备货较多等原因,消费电子需求较疲软,已进入去库存阶段,消费电子市场芯片价格有所下降。虽然 2022 年上半年公司晶圆制造业务主要生产工艺平均单价较 2021 年上半年仍有上升,但目前已出现了一定的下降趋势。2022 年上半年,发行人分立器件及模拟集成电路主要产品如浪涌保护器件、ECM 前置放大器的单价也较 2021 年有所下降。消费电子市场的周期性波动可能会对发行人的经营业绩产生一定负面影响。如果消费电子等发行人所处下游行业整体出现较大周期性波动,公司未能及时判断下游需求变化,或者受市场竞争格局变化、公司产能利用率走低、研发不及预期等因素影响,导致公司出现产品售价下降、销售量降低等不利情形,公司收入持续增长存在不确定性风险,短期内业绩会存在一定的下滑压力,公司主营业务毛利率也将面临下降风险,提请投资者关注。

(三)毛利率波动风险

公司报告期各期主营业务毛利率分别为 21.68%、28.66%、40.98%和 40.73%,毛利率呈上升趋势。公司的毛利主要来自于特种集成电路及器件产品,毛利率的变动与产品收入结构、市场竞争程度等因素有关,且公司产品种类繁多,不同产品的性能、用途及成本、价格存在一定差异。其中,公司晶圆制造毛利率分别为 -35.99%、-33.39%、21.79%及 19.82%,报告期内由负转正,但由于公司 2021 年生产线尚未达到满产状态,故虽然 2021 年晶圆制造业务毛利率为正,但仍低于同行业可比公司水平;封装测试业务毛利率分别为 -24.41%、-8.41%、-19.92%及 -23.04%,由于公司封装测试业务产线报告期内未完全达产、单位成本较高,报告期内毛利率持续为负,低于同行业水平。提请投资者关注公司晶圆制造及封装测试业务毛利率波动的风险。

(四)客户集中度较高的风险

2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月,公司向前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为 45.60%、44.12%、40.13%和 39.09%。公司客户相对集中,如果未来公司主要客户经营状况发生重大不利变化、采购需求下降或调整采购策略,可能导致公司订单下降,从而对公司经营业绩产生不利影响。

(五)政府补助减少的风险

报告期各期,公司获得的计入当期损益的政府补助分别为 2,804.22 万元、12,292.47 万元、15,039.42 万元和 6,241.04 万元,占同期归属于公司普通股股东的净利润比例分别为 -22.31%、210.16%、27.32%和 20.38%。未来,国家对半导体产业的鼓励政策可能面临调整,公司未来获得政府补助的情况存在不确定性,从而对公司的利润规模产生一定的不利影响。

(六)与募集资金运用的相关风险

公司本次募集资金拟投资项目中的“基于成套国产装备的特色工艺 12 吋集成电路生产线项目”已完成项目备案、环评等相关手续,并已实现部分设备的购置与搬入,一阶段预计将于 2023 年 4 月试生产,2024 年 7 月产品达产,二阶段预计将于 2024 年 4 月试生产,2025 年 7 月项目达产。该项目实施后公司固定资产规模将大幅增加,而募投项目投资回收期较长,因此在短期内募投项目新增折旧和摊销或将对发行人经营业绩产生一定的影响;同时如果发生公司 12 英寸线工艺平台开发遇到技术瓶颈、未采购到能够满足产线运行的设备、项目建设进度不及预期、市场环境发生重大不利变化、产能无法消化等情形,公司募集资金投资项目产生的收入及利润水平未实现既定目标,公司则可能面临无法按既定计划实现预期收益的风险。

(七)关联交易相关风险

报告期内,发行人的关联交易金额较高。其中购买商品、接受劳务的关联交易金额分别为 8,588.28 万元、17,225.65 万元、27,836.85 万元和 35,207.35 万元,占发行人总采购金额的比例分别为 4.91%、9.63%、13.02%和 15.87%;其中主要为向北方华创采购集成电路制造设备,交易金额分别为 7,381.11 万元、16,915.70 万元、26,960.83 万元和 33,943.25 万元。北方华创是中国大陆具有较强竞争力的高端微电子工艺装备制造企业,设备类型丰富,为我国国产集成电路设备的主要供应商之一,发行人的集成电路制造生产线采购了大量国产成套关键装备、实现了国产装备在大规模生产线上的量产应用验证,发行人向北方华创采购金额较大具有合理性,相关交易预计会持续发生。

报告期内,发行人销售商品、提供劳务的关联交易金额分别为 12,588.69 万元、4,887.57 万元、7,791.68 万元和 4,976.85 万元,占发行人营业收入的比例分别为 12.09%、4.74%、3.83%和 4.30%,报告期内呈下降趋势,交易对方主要为京东方及其子公司、飞宇电子。其中,与京东方及其子公司的交易主要为发行人原合并范围内子公司新相微向其销售显示驱动芯片、电源管理芯片等产品,2019 年 12 月起新相微不再纳入发行人合并范围之内;报告期内,由于业务承继等原因,发行人采取“飞宇电路实际生产并销售给飞宇电子、再由飞宇电子同最终客户签署合同”的销售模式,相关交易预计在较短的过渡期内会持续。

报告期内,发行人向北京电子城城市更新科技发展有限公司出租房屋,由其按照“集成电路设计创新中心”改建并运营管理燕东科技园区,同时向发行人支付使用费,合作运营期限为 20 年。2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月发行人确认的相关租赁收入分别为 3,326.69 万元、4,555.37 万元和 2,576.48 万元。

综上,由于发行人报告期内关联交易金额较高且部分交易预计会持续进行,提醒投资者关注相关风险。

第二节股票上市情况

一、股票发行上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

本公司首次公开发行人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请文件已于 2022 年 8 月 30 日经上交所科创板股票上市委员会审议通过,于 2022 年 10 月 25 日获中国证监会《关于同意北京燕东微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2575 号)注册同意。中国证监会注册同意具体内容如下:

“北京燕东微电子股份有限公司:

中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》和《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令第 174 号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申请文件,现批复如下:

一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司 A 股股票科创板上市已经上海证券交易所《关于北京燕东微电子股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》(自律监管决定书〔2022〕345 号)批准。公司 A 股股本为 119,910.4111 万股(每股面值 1.00 元),其中 119,644,800 股于 2022 年 12 月 16 日起上市交易,证券简称为“燕东微”,证券代码为“688172”。

二、股票上市相关信息

(一)上市地点及上市板块

本公司股票上市地点及上市板块为上海证券交易所科创板。

(二)上市时间

上市时间为 2022 年 12 月 16 日。

(三)股票简称

本公司股票简称为“燕东微”,扩位简称为“燕东微电子股份”。

(四)股票代码

本公司股票代码为“688172”。

(五)本次公开发行后的总股本

本次公开发行后的总股本为 119,910.4111 万股。

(六)本次公开发行的股票数量

本次公开发行的股票数量为 17,986.5617 万股,全部为公开发行的新股。

(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量

本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为 119,644,800 股。

(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量

本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为 1,079,459,311 股。

(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量

本次公开发行股票数量为 17,986.5617 万股,最终战略配售股数为 5,395.9685 万股,占本次发行数量的 30%。保荐机构依法设立的相关子公司中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投投资”)在本次发行中获配 4,549,590 股;发行人高级管理人员、核心员工通过资产管理计划最终获配股票数量为 3,877,337 股;其他战略投资者类型为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业,以及具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业,累计获配 45,532,758 股。本次发行最终战略配售结果如下:

序号	战略投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次发行数量的比例	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	合计金额(元)	限售期(月)
1	中信建投投资有限公司	参与跟投的保荐机构子公司	4,549,590	2.53%	99,999,988.20	0	99,999,988.20	24
2	中信建投基金-共赢7号员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“共赢7号资管计划”)	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	3,877,337	2.16%	85,223,867.26	426,119.34	85,649,986.60	12
3	北京京国管股权投资基金(有限合伙)	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	14,228,987	7.91%	312,753,134.26	1,563,765.67	314,316,899.93	12
4	产业投资基金有限责任公司	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	14,228,987	7.91%	312,753,134.26	1,563,765.67	314,316,899.93	12
5	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	17,074,784	9.49%	375,303,752.32	1,876,518.76	377,180,271.08	12
-	合计		53,959,685	30.00%	1,186,033,876.30	5,430,169.44	1,191,464,045.74	-

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限

本次发行前股东所持股份的流通限制及期限参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于本次发行前所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股、减持意向等承诺”。

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺的具体内容请参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于本次发行前所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股、减持意向等承诺”。

(十二)本次上市股份的其他限售安排

本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

战略配售部分,保荐机构依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算,对应的股份数量为 4,549,590 股,占发行后总股本的 0.38%。除保荐机构相关子公司之外的其他战略配售投资者本次获配股票的限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算,对应的股份数量为 49,410,095 股,占发行后总股本的 4.12%。

本次网下发行部分,获配的公开募集方式设立的公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户(向上取整计算),根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。本次发行参与网下配售摇号的共有 2,270 个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为 227 个。对应的股份数量为 6,261,132 股,占本次发行后总股本的 0.52%。

(十三)股票登记机构

本公司股票的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

(十四)上市保荐机构

本公司股票上市保荐机构为中信建投证券。

三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

本次发行价格确定后发行人上市时市值为 263.56 亿元,发行人 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润 38,538.43 万元,发行人 2021 年度经审计的营业收入为 203,469.96 万元,满足在招股说明书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条的第一项标准:

“(一)预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

第三节发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

中文名称:	北京燕东微电子股份有限公司
英文名称:	Beijing YanDong MicroElectronic Co., Ltd.
注册资本(本次发行前):	1,019,238,494 元人民币
法定代表人:	谢小明
成立日期:	1987年 10 月 6 日
整体变更为股份有限公司日期:	2021年 3 月 26 日
住所:	北京市朝阳区东直门外西八间房
经营范围:	制造、加工半导体器件;设计、销售半导体器件及其应用技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;机动车公共停车场服务;出租商业用房、出租办公用房;物业管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主营业务:	燕东微是一家集芯片设计、晶圆制造和封装测试于一体的半导体企业,经过三十余年的积累,公司已发展为国内知名的集成电路及分立器件制造和系统方案提供商。
所属行业:	C39计算机、通信和其他电子设备制造业
董事会秘书:	霍凤祥
邮政编码:	100176
电话:	010-50973019
传真:	010-50973016
互联网网址:	http://www.ydme.com
电子信箱:	bso@ydme.com
信息披露和投资者关系负责部门:	董事会办公室
信息披露和投资者关系负责人:	霍凤祥(董事会秘书)
信息披露和投资者关系负责人联系电话:	010-50973019

二、控股股东、实际控制人的基本情况

(一)控股股东、实际控制人基本情况

发行人控股股东及实际控制人为北京电控,本次发行后北京电控直接持有发行人 420,573,126 股股份,占公司全部股份的比例为 35.07%,北京电控通过下属单位电控产投、京东方创投、电子城分别间接持有公司 0.78%、7.77%和 1.88%的股份,并通过一致行动人盐城高投及联芯一号等十家员工持股平台间接控制公司 3.77%和 1.92%的股份,合计控制公司 53.04%的股份。

北京电控基本情况如下:

中文名称	北京电子控股有限责任公司		
英文名称	Beijing Electronics Sharesholding Co., Ltd.		
统一社会信用代码	91110000633647998H		
企业类型	有限责任公司(国有独资)		
法定代表人	王岩		
注册资本	313,921 万元人民币		
实收资本	130,737 万元人民币		
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥路 12 号		
主要生产经营地	北京		
主营业务	半导体显示、集成电路、新能源等		
成立日期	1997年 04 月 08 日		
股东构成	股东名称	注册资本	股权比例
	北京国有资本运营管理有限公司	313,921 万元人民币	100.00%

北京电控最近一年及一期简要财务数据如下:

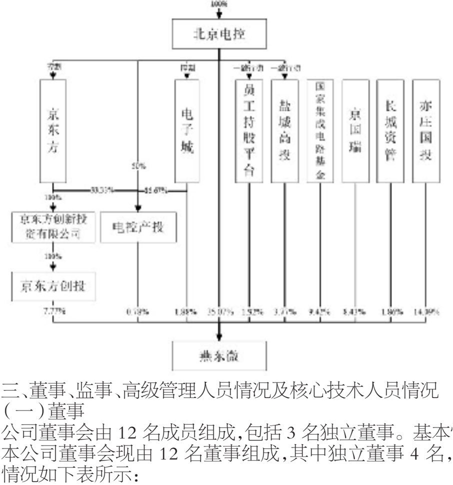
单位:万元

项目	2022年 1-6 月/2022 年 6 月 30 日	2021年度/2021 年 12 月 31 日
总资产	1,764,630.59	1,662,777.40
净资产	867,436.80	898,129.81
净利润	-361.69	56,315.89

注:上述数据为母公司财务数据,其中,2022 年 1-6 月数据未经审计,2021 年度数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)本次发行后的股权结构控制关系图

本次公开发行后,发行后公司总股本为 119,910.4111 万股。本次发行后,公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:



三、董事、监事、高级管理人员情况及核心技术人员情况

(一)董事

公司董事会由 12 名成员组成,包括 3 名独立董事。基本情况如下:

本公司董事会现由 12 名董事组成,其中独立董事 4 名,本公司董事会成员情况如下表所示:

序号	姓名	职位	任期	提名人
1	谢小明	董事长	2021年 3 月 26 日 -2024 年 3 月 25 日	北京电控
2	朱保成	副董事长	2021年 3 月 26 日 -2024 年 3 月 25 日	北京电控
3	淮永进	董事、总经理	2021年 3 月 26 日 -2024 年 3 月 25 日	北京电控
4	王海鹏	董事	2021年 3 月 26 日 -2024 年 3 月 25 日	北京电控
5	岳占秋	董事	2021年 9 月 26 日 -2024 年 3 月 25 日	京东方创投
6	梁望南	董事	2021年 3 月 26 日 -2024 年 3 月 25 日	京国瑞
7	韩向晖	董事	2021年 3 月 26 日 -2024 年 3 月 25 日	亦庄国投
8	龚巍巍	董事	2021年 9 月 26 日 -2024 年 3 月 25 日	国家集成电路基金
9	任天令	独立董事	2021年 3 月 26 日 -2024 年 3 月 25 日	公司董事会
10	韩郑生	独立董事	2021年 3 月 26 日 -2024 年 3 月 25 日	公司董事会
11	李轩	独立董事	2021年 3 月 26 日 -2024 年 3 月 25 日	公司董事会
12	周华	独立董事	2021年 3 月 26 日 -2024 年 3 月 25 日	公司董事会

(二)监事

公司共有 5 名监事,该等人员情况如下所示:

姓名	职务	任期	提名人
王爱清	监事会主席	2022年 5 月 20 日 -2024 年 3 月 25 日	北京电控
刘晓玲	监事	2021年 9 月 26 日 -2024 年 3 月 25 日	国家集成电路基金
元巍	监事	2021年 3 月 26 日 -2024 年 3 月 25 日	亦庄国投
曹立新	监事	2021年 8 月 13 日 -2024 年 3 月 25 日	职工代表选举产生
刘娟娟	监事	2021年 6 月 17 日 -2024 年 3 月 25 日	职工代表选举产生

(三)高级管理人员

公司现有高级管理人员 7 名,情况如下表所示:

序号	姓名	职务	任期起止日期
1	淮永进	董事、总经理	2021年 3 月 26 日 -2024 年 3 月 25 日
2	霍凤祥	副总经理、董事会秘书	2021年 3 月 26 日 -2024 年 3 月 25 日
3	张晖	副总经理	2021年 3 月 26 日 -2024 年 3 月 25 日
4	徐涛	财务总监	2021年 9 月 3 日 -2024 年 3 月 25 日
5	李剑锋	副总经理	2021年 3 月 26 日 -2024 年 3 月 25 日
6	唐晓琦	副总经理	2021年 3 月 26 日 -2024 年 3 月 25 日
7	陈兆震	副总经理	2021年 3 月 26 日 -2024 年 3 月 25 日

(四)核心技术人员

公司共有 4 名核心技术人员,该等人员情况如下表所示:

序号	姓名	职务
1	张彦秀	企业技术中心常务副主任
2	韦仕贡	企业技术中心副主任
3	周源	企业技术中心副主任
4	ZHANG XIAOLIN	技术总监

(五)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份及债券的情况

本次发行前,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员间接持有公司股份情况如下:

序号	姓名	职位	持股企业	在持股企业出资比例	持股企业持有发行人股份比例	间接持股数量(万股)	间接持有发行人股份比例
1	谢小明	董事长	联芯八号	9.5238%	0.26%	30.00	0.03%
2	淮永进	董事、总经理	联芯八号	9.5238%	0.26%	30.00	0.03%
3	王海鹏	董事	联芯八号	9.5238%	0.26%	30.00	0.03%
4	霍凤祥	副总经理、董事会秘书	联芯八号	9.5238%	0.26%	30.00	0.03%
5	张晖	副总经理	联芯八号	9.5238%	0.26%	30.00	0.03%
6	徐涛	财务总监	联芯二号	7.8534%	0.32%	30.00	0.03%
7	李剑锋	副总经理	联芯二号	7.8534%	0.32%	30.00	0.03%
8	唐晓琦	副总经理	联芯十一号	25.8621%	0.10%	30.00	0.03%
9	陈兆震	副总经理	联芯二号	7.8534%	0.32%	30.00	0.03%
10	张彦秀	企业技术中心常务副主任	联芯一号	3.5443%	0.33%	14.00	0.01%
11	韦仕贡	企业技术中心副主任	联芯一号	3.5443%	0.33%	14.00	0.01%
12	周源	企业技术中心副主任	联芯二号	4.1885%	0.32%	16.00	0.01%
13	方宇	公司技术骨干,核心技术人员周源之妻子	联芯二号	0.7853%	0.32%	3.00	0.003%
14	ZHANGXIAOLIN	技术总监	联芯九号	12.1951%	0.21%	30.00	0.03%

公司上述董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过公司员工持股平台间接持有公司股份的限售期限均为自上市之日起锁定 36 个月。

本次发行后,公司部分董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过共赢 7 号资管计划持有本公司股份,限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。共赢 7 号资管计划的具体情况参见本节“八、本次战略配售情况”。

截至本上市公告书签署日,除上述情形外,公司不存在其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接和间接持有发行人股份的情况。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所持发行人股份不存在被质押或冻结的情况,亦不存在持有发行人债券的情况。

(六)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的流通限制及期限参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于本次发行前所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股、减持意向等承诺”。

(七)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况

截止本上市公告书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。

四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排

截至本上市公告书签署日,公司不存在已制定或实施的股权激励及相关安排。

五、本次公开发行申报前实施的员工持股计划及相关安排

公司采用间接持股的方式对高级管理人员和核心员工等进行股权激励,充分调动了员工的积极性和创造性,建立健全公司长效激励机制,同时肯定员工对公司做出的贡献,与员工分享公司的经营成果,提升团队凝聚力,有利于稳定核心员工和提高公司的经营状况。截至 2022 年 9 月 30 日,联芯一号、联芯二号、联芯三号、联芯五号、联芯六号、联芯七号、联芯八号、联芯九号、联芯十号和联芯十一号等十家合伙企业均为发行人员工持股平台。

截至 2022 年 9 月 30 日,发行人 10 个员工持股平台合计持有发行人 2.26%的股份,员工持股平台的具体情况如下:

1、基本情况及股权结构

(1)联芯一号

企业名称	北京联芯一号科技合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91110400MA04EWKW39
类型	有限合伙企业
主要经营场所	北京市北京经济技术开发区中和街 14 号 2 幢 2 层 2002 号(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
执行事务合伙人	杨洁
成立日期	2021年 9 月 6 日
合伙期限	2021年 9 月 6 日至 2041 年 9 月 5 日
经营范围	集成电路设计;信息技术、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;企业管理咨询;企业形象策划;商务信息咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

联芯一号系发行人的员工持股平台企业,杨洁系联芯一号的普通合伙人及执行事务合伙人,成立目的是持有激励股权,由激励对象作为合伙人,通过联芯一号向发行人增资并间接持有发行人股权。

截至 2022 年 9 月 30 日,联芯一号的合伙人及其出资情况、在发行人处担任职务如下:

序号	合伙人姓名	认缴出资额(万元)	出资比例	合伙人类型	在发行人处担任职务
1	杨洁	174.40	4.0506%	普通合伙人	公司总监
2	燕相静	43.60	1.0127%	有限合伙人	公司技术组长
3	王四新	141.70	3.2911%	有限合伙人	所属公司副总经理
4	于锋	65.40	1.5190%	有限合伙人	所属公司副部长
5	段旭东	21.80	0.5063%	有限合伙人	所属公司技术骨干
6	张珍珍	65.40	1.5190%	有限合伙人	公司专业技术主管
7	赵鑫	65.40	1.5190%	有限合伙人	公司专业技术主管
8	鲍明	54.50	1.2658%	有限合伙人	公司专业技术主管
9	高向海	65.40	1.5190%	有限合伙人	所属公司副部长
10	李海强	65.40	1.5190%	有限合伙人	所属公司副部长
11	姜冬梅	21.80	0.5063%	有限合伙人	所属公司技术骨干
12	高晓翠	54.50	1.2658%	有限合伙人	所属公司技术骨干
13	张玉	32.70	0.7595%	有限合伙人	所属公司技术骨干
14	查建平	65.40	1.5190%	有限合伙人	所属公司副部长
15	李国栋	174.40	4.0506%	有限合伙人	所属公司副总经理
16	张欣慰	65.40	1.5190%	有限合伙人	公司技术骨干
17	邱晓凯	174.40	4.0506%	有限合伙人	公司总监
18	蔡振宇	327.00	7.5949%	有限合伙人	公司纪委书记
19	陈岳	54.50	1.2658%	有限合伙人	所属公司专业技术主管
20	林锐	32.70	0.7595%	有限合伙人	所属公司技术骨干
21	康磊	174.40	4.0506%	有限合伙人	所属公司副总经理
22	李晓锋	174.40	4.0506%	有限合伙人	所属公司副总经理
23	张鹏	174.40	4.0506%	有限合伙人	所属公司副总经理
24	王少辉	54.50	1.2658%	有限合伙人	所属公司副部长
25	刘伟	109.00	2.5316%	有限合伙人	公司副部长
26	江松	54.50	1.2658%	有限合伙人	所属公司技术骨干
27	王佳鹏	65.40	1.5190%	有限合伙人	所属公司副部长
28	韦仕贡	152.60	3.5443%	有限合伙人	公司副主任
29	杨宝泉	327.00	7.5949%	有限合伙人	所属公司总经理
30	张燏	174.40	4.0506%	有限合伙人	所属公司副总经理
31	孙平静	65.40	1.5190%	有限合伙人	所属公司专业技术主管
32	张彦秀	152.60	3.5443%	有限合伙人	公司常务副主任
33	孙长安	174.40	4.0506%	有限合伙人	所属公司副总经理
34	赵美星	54.50	1.2658%	有限合伙人	所属公司部长
35	坑晓雨	54.50	1.2658%	有限合伙人	所属公司技术骨干
36	李可	109.00	2.5316%	有限合伙人	所属公司总经理
37	徐鸿卓	109.00	2.5316%	有限合伙人	公司部长
38	景春红	54.50	1.2658%	有限合伙人	所属公司技术骨干
39	王彩集	54.50	1.2658%	有限合伙人	所属公司副部长
40	李立松	174.40	4.0506%	有限合伙人	所属公司副总经理
41	高雪艳	43.60	1.0127%	有限合伙人	公司专业技术主管
42	孙景琦	32.70	0.7595%	有限合伙人	所属公司部长
合计		4,305.50	100.00%	-	-

(2)联芯二号

(下转 C2 版)